

5-147383-9 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 50/50 Grid

TE 内部编号 5-147383-9

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, Black, AMPMODU 50/50 Grid

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 100

行数: 2

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 板对板 |
| 接头类型 | 全部带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|-----------|-------|
| 板对板配置 | 平行 |
| 连接器端子负载状态 | 选择性装载 |
| 位数 | 100 |
| 行数 | 2 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VAC |
|------|--------|

主体特性



| | |
|--------------|-------|
| PCB 保持特性材料 | 铜合金 |
| PCB 保持特性电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

| | |
|----------------|-----------------|
| | 150 μ m |
| 接合插针直径 | .46 mm[.018 in] |
| 端子形状和构造 | 圆形, 圆形 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流 (最大值) | .5 A |

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 圆形端接柱体和尾部直径 | .46 mm[.018 in] |
| | .03 in |
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |

机械附件

| | |
|------------|------|
| 接合对准类型 | 键控 |
| PCB 安装固定类型 | 压具柱体 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装固定 | 带有 |

壳体特性

| | |
|----------|-----------------|
| 外壳材料 | LCP (液晶聚合物) |
| 中心线 (间距) | 1.27 mm[.05 in] |

尺寸

| | |
|------|-----------------|
| 堆叠高度 | 9.91 mm[.39 in] |
| 行间距 | 1.27 mm[.05 in] |

使用环境

| | |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C |
|--------|--------------|

操作/应用

| | |
|--------|-----|
| 装配工艺特点 | 真空盖 |
|--------|-----|



行业标准

| | |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|------------|
| 封装数量 | 300 |
| 封装方法 | 卷带包装, 卷带包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 Grid



客户还购买了



文档

产品图纸

[100 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-147383-9_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-147383-9_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-147383-9_D.3d_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2](#)

英文版本

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

[Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU 50/50 Grid Connectors](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本